

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他 券商策略会、电话会议
参与单位名称	国泰海通策略会（11月5日） 华创证券策略会（11月5日） 招商证券策略会（11月5日） 西部证券（11月6日） 福州汉石基金（11月6日） 东方财富证券（11月6日） 广发基金（11月6日） 华泰资产管理（11月6日） 中银基金（11月6日） 建信基金（11月6日） 国寿养老（11月7日） 国寿资管（11月7日） 兴业基金（11月10日） 创金合信（11月10日） 民生证券（11月10日） 青骊投资（11月10日） 花旗银行策略会（11月12日） 汇添富基金（11月12日）

	运舟资本（11月12日） 巨子私募基金（11月12日） 浙江壁虎投资管理（11月12日） 鑫元基金（11月12日） 景顺长城（11月12日） 姚泾河投资（11月12日） 东方阿尔法基金（11月12日） 轩汉投资（11月12日） 敦和资管（11月12日） 中欧瑞博投资（11月12日） 国泰海通资管（11月12日） 广发证券（11月12日） 博时基金（11月12日） 上海兆顺基金（11月12日） 博普资产（11月12日） 中信建投证券策略会（11月13日） 国海证券（11月14日） 中邮创业基金（11月14日） 国投证券策略会（11月18日） 东方财富证券策略会（11月19日） 甬兴证券（11月25日）
时间	2025 年 11 月 5 日—11 月 25 日
地点	公司会议室、北京、上海
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2025 年前三季度经营情况 公司 2025 年前三季度实现营业收入 390,281.72 万元，较去年

同期增长 66.53%，归属于上市公司股东的净利润 49,170.68 万元，较去年同期增长 142.19%，主要原因是：（1）AI 算力高多层板及高多层 HDI 板市场规模增长及技术难度双重提升，对高技术附加值专用加工设备的需求持续上升。公司紧抓下游客户扩产机遇，针对 AI PCB 提供一站式专用设备解决方案，包含高厚径比通孔、高精度背钻及高速材料盲孔加工方案，高精度线路转移及检查方案，高可靠性质量检测方案等产品，同时满足客户大批量设备快速交付的要求，受到行业龙头客户的广泛认可；（2）公司持续提升汽车电子、消费电子等多层板及 HDI 板加工设备的综合竞争力，钻孔类、曝光类及检测类设备等产品的性能和加工效率不断优化，助力下游客户降低运营成本，从而获得更高市场份额。

二、PCB 行业发展趋势

2025 年以来，国内外云解决方案提供商持续提升算力中心投入，AI 算力数据中心服务器、交换机、光模块等终端需求延续强劲态势，PCB 产业直接受益，以高多层板为主的细分市场需求快速攀升，促进下游 PCB 企业投资力度加大。行业知名研究机构 Prismark 预估 2025 年 PCB 产业营收和产量分别成长 7.6% 和 7.8%，其中与 AI 服务器和交换机相关的高多层板及 HDI 板增长最为强劲，2024-2029 年产能复合成长率分别高达 22.1% 和 17.7%。

三、公司产品情况

随着数据量的急剧增长，AI 服务器、高速交换机等终端单通道 112/224Gbps SerDes 设计被广泛采用，需要更高层数、更高密度的高速多层板及高多层 HDI 板来承载，为确保高速 PCB 的信号完整性，对孔、线路及成品品质提出更高要求。

在对 PCB 专业加工设备的需求方面，无论高速材料的变更，还是厚径比的上升，都导致机械钻孔机效率大幅降低，加工同样面积的 AI PCB 产品所需设备数量大幅增加；而信号完整的提高，背钻孔数提升的同时加工精度要求更高，对更高技术附加值的 CCD 六轴独立机械钻孔机的需求量更多。除公司原有优势产品一经典双龙门设计机械钻孔机持续获得客户复购外，新开发的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机，可实现超短残桩及超高位置精度的背钻孔加工，也已获得行业终端客户的认证及多家高多层板龙头企业的大批量采购；而针对高多层 HDI 板的加工需求，除以上提到的机械钻孔机产品需求外，还需要更多的激光钻孔

	机来满足多阶堆叠盲孔或深盲孔加工，公司研发的高功率及能量实时监测的 CO₂ 激光钻孔机可实现大孔径及跨层盲孔的高品质加工。 另外，AI 智能手机、800G⁺ 光模块等逐步采用类载板，带动了微小孔、槽及外形的高精度加工需求，公司提供新型激光加工方案，突破传统 CO₂ 激光热效应大的瓶颈，实现微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工的高品质要求，为行业新兴应用提供新动力，已获得下游客户工艺认可及正式订单。 公司相关设备方案不断进行优化，突破 AI 服务器产业链终端客户设计及 PCB 主力厂商生产的技术瓶颈，提供满足 AI 服务器等大厚板日益增加的高厚径比、更严格阻抗公差、更高信号完整性、更高电性能需求的高可靠性加工方案，并在产能和交付方面具有极大的区位优势，助力下游客户快速扩大增长强劲的 AI PCB 市场竞争力。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 26 日